



半導體元件物理與製程技術課程

■ 課程簡介

課程從半導體元件物理基礎介紹，再輔以市場應用與趨勢的角度認識半導體。

■ 課程對象

1. 半導體產業與平面製造相關工程師與技術相關人員，欲有系統學習半導體產業整體知識與技術趨勢者。
2. 半導體產業及其上下游行業公司之產品人員、生產線工程師與主管、行銷人員、品管人員、工業工程人員、專案管理人員等。
3. 各大專院校之理工科系之大四學生及碩博士生。

■ 課程大綱

- 元件物理與製程
- 薄膜沉積技術
- 微影技術
- 蝕刻技術
- 離子佈植技術
- 氧化與熱製程技術
- CMP 與平坦化製程
- CMOS 製程整合

■ 講師簡介

-張老師-

【現職】國立中山大學 物理系 特聘教授

【專長】薄膜電晶體 (TFT) 平面顯示器、前瞻電晶體元件、記憶體元件



【經歷】國立中山大學物理系教授/副教授、國家奈米元件實驗室研究員

■ 舉辦日期：108/11/06(三) – 108/11/07(四) 09:30 -16:30 (共 12 hrs)

■ 地點：工研院產業學院 台北學習中心 (實際地點以上課通知為準!)

■ 主辦單位：工研院產業學院 台北學習中心

■ 費用：

原價	早鳥價 (開課 10 天前報名)	團報價 (同一公司二人以上報名)
每人 8,000 元	每人 7,500 元	每人 7,000 元